

# 2025-2031年中国半导体用环氧塑封料行业市场调研分析及发展规模预测报告

报告大纲

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2025-2031年中国半导体用环氧塑封料行业市场调研分析及发展规模预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/202201/992856.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

智研咨询组织编撰的《2025-2031年中国半导体用环氧塑封料行业市场调研分析及发展规模预测报告》（以下简称“《报告》”）是中国半导体用环氧塑封料领域的专业市场研究报告，是半导体用环氧塑封料行业发展忠实的记录者和见证者。旨在为中国半导体用环氧塑封料行业生产厂家、政府机构、业界专家了解和掌握中国半导体用环氧塑封料发展脉络提供全面参考。

《报告》自2019年开始出版，每年一版，目前已连续6年。智研咨询研究团队持续跟进半导体用环氧塑封料发展历程，总结现状、深化研究、探索规律，《报告》总计15章，从行业界定、发展环境、区域市场、产品价格、细分市场、供需形势、进出口现状、竞争格局、重点企业、投资风险、发展前景等多个方面，通过详实的数据，全面总结和回顾了2023年半导体用环氧塑封料行业的新趋向、新亮点，同时对现存问题进行了深度思考，为下一步半导体用环氧塑封料行业高质量发展提出了一系列有益的建议和未来的展望。

环氧塑封料在用于半导体芯片封装时，不但保护了芯片不受外部环境的影响，特别是免受外部机械物理力（例如冲击和压力）和外部化学力（例如水分、热量和紫外线）的影响，而且为芯片提供了散热通道。在保证芯片电绝缘性的同时，提供了一种半导体封装的形式使其更易于安装在印刷电路板上。据统计，2023年我国半导体用环氧塑封料产量为12.74万吨，需求量为19.04万吨，市场规模为93.87亿元。

半导体用环氧塑封料行业产业链上游原材料主要包括电子环氧树脂、硅微粉、酚醛树脂以及其他添加剂。这些原材料是生产环氧塑封料的基础，决定了最终产品的性能和质量。中游主要是环氧塑封料的生产商。下游主要包括半导体封装企业和最终用户，应用于消费电子、光伏、汽车电子、工业应用和物联网等领域的企业。

目前我国电子封装材料中的环氧封装材料生产的主要技术掌握在几家规模生产企业手上，行业集中度高。国内半导体用环氧塑封料生产商主要有德高化成、衡所华威、中科科化、华海诚科、中新泰合、飞凯材料等。

其中华海诚科是一家专业从事半导体器件、集成电路、特种器件、LED支架等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业。2023年公司营收2.83亿元，同比下降6.7%，归属净利润为0.32亿元，同比下降23.26%。飞凯材料半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶及湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等，用于集成电路传统封装领域的锡球、环氧塑封料等。2023年公司营收27.29亿元，同比下降5.52%，归属净利润为1.12亿元，同比下降74.15%。德高化成是一家深耕于半导体封装用高分子复合材料的专业生产商和供应商。2023年公司营收0.98亿元，同比增长20.66%，归属净利润为0.05亿元，同比增长250.07%。

智研咨询研究团队围绕中国半导体用环氧塑封料产业规模、产业结构、重点企业情况、产业发展趋势等方面进行深入分析，并针对半导体用环氧塑封料产业发展中存在的问题提出建议，为各地政府、产业链关联企业、投资机构提供参考。

报告目录：

## 第一章 半导体用环氧塑封料（EMC）行业界定和分类

### 第一节 行业定义、基本概念

### 第二节 行业基本特点

### 第三节 行业分类

### 第四节 半导体用环氧塑封料（EMC）特性

## 第二章 半导体用环氧塑封料（EMC）行业国内外发展概述

### 第一节 全球半导体用环氧塑封料（EMC）行业发展概况

### 第二节 中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业发展概况

## 第三章 2024年中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业发展环境分析

### 第一节 宏观经济环境

### 第二节 宏观政策环境

### 第三节 国际贸易环境

### 第四节 半导体用环氧塑封料（EMC）行业政策环境

### 第五节 半导体用环氧塑封料（EMC）行业技术环境

## 第四章 中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业市场分析

### 第一节 2020-2024年中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业市场规模

### 第二节 中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业市场结构

### 第三节 2023年中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业市场特点

## 第五章 中国半导体用环氧塑封料（EMC）区域市场分析

### 第一节 区域市场分布情况分析

### 第二节 重点区域市场需求分析（需求规模、需求特征等）

## 第六章 中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业生产分析

### 第一节 产能产量分析

### 第二节 区域生产分析

### 第三节 行业供需平衡分析

## 第七章 2020-2024年中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业产品价格分析

### 第一节 半导体用环氧塑封料（EMC）产品价格特征

#### 第二节 国内半导体用环氧塑封料（EMC）产品当前市场价格评述

#### 第三节 影响国内市场半导体用环氧塑封料（EMC）产品价格的因素

#### 第四节 半导体用环氧塑封料（EMC）产品未来价格变化趋势预测分析

## 第八章 中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业细分行业概述

### 第一节 主要半导体用环氧塑封料（EMC）细分行业

#### 一、分立器件封装细分行业

##### （一）分立器件行业

##### （二）分立器件封装行业

#### 二、集成电路封装细分行业

##### （一）集成电路行业

##### （二）集成电路封装行业

### 第二节 各细分行业需求与供给分析

#### 一、分立器件封装细分行业

#### 二、集成电路封装细分行业

### 第三节 细分行业发展趋势预测分析

#### 一、分立器件封装细分行业

#### 二、集成电路封装细分行业

## 第九章 2020-2024年半导体用环氧塑封料（EMC）行业主导驱动因素分析

### 第一节 国家政策导向

### 第二节 关联行业发展

#### 一、电子化学品行业发展概况

#### 二、半导体产业发展状况分析

#### 三、塑封料产业的现状调研

### 第三节 行业技术发展

### 第四节 行业竞争情况分析

### 第五节 社会需求的变化

## 第十章 2020-2024年中国半导体用环氧塑封料（EMC）所属行业经济运行分析

### 第一节 中国半导体用环氧塑封料（EMC）所属行业盈利能力分析

第二节 中国半导体用环氧塑封料（EMC）所属行业成长性分析

第三节 中国半导体用环氧塑封料（EMC）所属行业偿债能力分析

第四节 中国半导体用环氧塑封料（EMC）所属行业营运能力分析

第十一章 2020-2024年中国半导体用环氧塑封料（EMC）所属行业进、出口现状调研

第一节 出口情况分析

第二节 进口情况分析

第十二章 2020-2024年中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业竞争分析

第一节 重点半导体用环氧塑封料（EMC）企业市场份额

第二节 半导体用环氧塑封料（EMC）行业市场集中度

第三节 行业竞争群组

第四节 潜在进入者

第五节 替代品威胁

第六节 供应商议价能力

第七节 下游用户议价能力

第十三章 2020-2024年中国半导体用环氧塑封料（EMC）主要生产企业分析

第一节 衡所华威电子有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第二节 北京科化新材料科技有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第三节 长兴电子材料（昆山）有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第四节 江苏华海诚科新材料股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第五节 天津德高化成新材料股份有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业经营情况分析
- 三、企业经营优劣势分析

#### 第六节天津凯华绝缘材料股份有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业经营情况分析
- 三、企业经营优劣势分析

### 第十四章 2025-2031年中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业发展与投资风险分析

#### 第一节 半导体用环氧塑封料（EMC）行业环境风险

#### 第二节 产业链上、下游及各关联产业风险

#### 第三节 半导体用环氧塑封料（EMC）行业政策风险

#### 第四节 半导体用环氧塑封料（EMC）行业市场风险

### 第十五章 中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业发展前景及投资机会分析

#### 第一节 半导体用环氧塑封料（EMC）行业发展前景预测分析

##### 一、用户需求变化预测分析

###### （一）分立器件封装

###### （二）集成电路行业

##### 二、竞争格局发展预测分析

##### 三、渠道发展变化预测分析

##### 四、行业总体发展前景及市场机会分析

#### 第二节 半导体用环氧塑封料（EMC）企业营销策略

#### 第三节 半导体用环氧塑封料（EMC）企业投资机会

##### 一、子行业投资机会

###### （一）低端分立器件行业

###### （二）中高端-规模集成电路

##### 二、区域市场投资机会

##### 三、产业链投资机会

#### 图表目录：部分

图表1：2020-2024年全球环氧塑封料市场规模

图表2：环氧塑封料国内主要生产企业

图表3：2020-2024年我国半导体材料市场规模统计图

图表4：2020-2024年我国半导体材料销售收入统计图

图表5：半导体用环氧塑封料（EMC）行业产能结构

图表6：2020-2024年中国半导体用环氧塑封料进口占比情况

图表7：2024年中国半导体用环氧塑封料市场规模区域结构

图表8：2020-2024年我国半导体用环氧塑封料（EMC）产量走势

图表9：2020-2024年半导体用环氧塑封料（EMC）产量区域分布格局

图表10：2020-2024年我国半导体用环氧塑封料（EMC）产销量统计图

图表11：2020-2024年中国环氧塑封料行业市场均价走势

图表12：2025-2031年中国环氧塑封料行业价格走势预测

图表13：2020-2024年中国集成电路行业供需平衡走势

图表14：2020-2024年我国集成电路产量走势

图表15：2020-2024年中国半导体分立器件产量走势

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/202201/992856.html>